(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
21. Juni 2012 (21.06.2012)

WIPO | PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2012/079597 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
H01L 21/683 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2010/007610

(22) Internationales Anmeldedatum:
14. Dezember 2010 (14.12.2010)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(71) Anmelder *(für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US)*: **EV GROUP E. THALLNER GmbH** [AT/AT]; 1, Dl Erich Thallner Straße, AT - 4782 St. Florian am Inn (AT).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder *(nur für US)*: **WIMPLINGER, Markus** [AT/AT]; 84, Braunauerstrasse, AT-4910 Ried im Innkreis (AT). **WAGENLEITNER, Thomas** [AT/AT]; 15, Eitzingerstraße, AT-4971 Aurolzmünster (AT). **FILBERT, Alexander** [AT/AT]; 3/5, Rahaberg Hof, AT-4782 St. Florian am Inn (AT).

(74) Anwälte: **SCHWEIGER, Johannes** et al.; Becker & Müller, 22, Turmstrasse, 40878 Ratingen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten *(soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart)*: AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

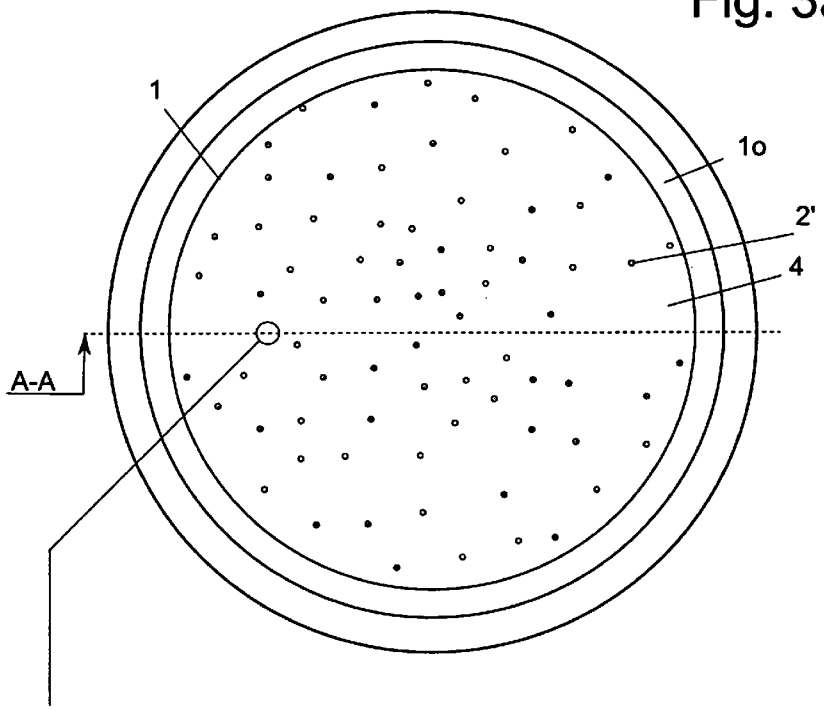
(84) Bestimmungsstaaten *(soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart)*: ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: HOLDING DEVICE FOR HOLDING AND MOUNTING A WAFER

(54) Bezeichnung : AUFNAHMEEINRICHTUNG ZUR AUFNAHME UND HALTERUNG EINES WAFERS

Fig. 3a



(57) Abstract: The present invention relates to a holding device for holding and mounting a wafer for the purpose of machining the wafer with a mounting face for holding the wafer on a contact face of the wafer and retaining means for mounting the wafer, wherein the retaining means achieve mounting of extremely thin wafer on the mounting face of the wafer and the smallest possible local distortions in the wafer.

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2012/079597 A1

SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— *mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)*

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Aufnahmeeinrichtung zur Aufnahme und Halterung eines Wafers zur Bearbeitung des Wafers mit einer Halterungsfläche zur Aufnahme des Wafers an einer Auflagefläche des Wafers und Haltemitteln zur Halterung des Wafers, wobei durch die Haltemittel eine Halterung von extrem dünnen Wafern an der Halterungsfläche des Wafers möglichst geringe lokale Verzerrungen des Wafers erreicht werden.